

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-087

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 签订项目合作协议暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**晶圆级先进封测制造项目三期（以下简称“本项目”）
- **投资金额：**深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）、控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“广东芯成汉奇”）拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶圆级先进封测制造项目三期合作协议》（以下简称“本协议”），预计晶圆级先进封测制造项目三期（以下简称“本项目”）总投资约 45 亿元人民币，其中固定资产投资 40 亿元（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等）。具体将根据本项目实际进展分阶段投入，最终以本项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

2026 年 9 月 21 日公司召开第四届董事会第二十三次会议，全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》，公司拟在原预计总投资额的基础上再增加投资约 45 亿元人民币（最终以项目建设实际投资开支为准）建设晶圆级先进封测制造项目三期。董事会授权公司经营管理层制定与实施具体方案、签订设备购置及建设施工等相关协议或文件，及办理其他与本项目相关的一切事宜。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

● 晶圆级先进封测制造项目一期、二期进展情况

1、投资进展情况：晶圆级先进封测制造项目一期、二期计划（具体详见 2023 年 10 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议暨对外投资的

公告》)投资 30.9 亿元已完成,设备陆续交付中,对应月产能约 3,000 片(2.5D 产能)。截至本公告披露日,一期项目已完成厂房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户送样、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术储备情况:广东芯成汉奇已构建覆盖 2.5D、RDL、Fan-in、Fan-out 等多种先进封装技术。本次三期项目系在原项目基础上的增资扩产,建设内容在原项目工业用地内完成,不涉及新增用地。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯成汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯成汉奇无法履约时,公司须对广东芯成汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯成汉奇的持股比例为限。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯成汉奇(作为晶圆级先进封测制造项目一期、二期(以下简称“原项目”)、三期实施主体),拟与东莞松山湖新技术产业开发区管理委员会签订《晶圆级先进封测制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为 45 亿元人民币(最终项目投资总额以实际投资为准)。其中固定资产投资 40 亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等)。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	晶圆级先进封测制造项目三期
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>450,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☒ 其他： <u>自筹资金</u> ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

1、2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年第五次临时股东大会，均审议通过《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议暨对外投资的议案》，同意公司、控股子公司广东芯成汉奇（作为晶圆级先进封测制造项目一期、二期实施主体）与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资意向协议》（以下简称“原协议”），股东大会同意授权公司管理层负责办理本项目实施及开展相关的一切事宜。具体详见 2023 年 10 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议暨对外投资的公告》。

2、2026 年 9 月 21 日公司召开第四届董事会第二十三次会议，全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》，公司拟在原预计总投资额的基础上再增加投资约 45 亿元人民币（最终以项目建设实际投资开支为准）建设晶圆级先进封测制造项目三期。

董事会授权公司经营管理层制定与实施具体方案、签订设备购置及建设施工等相关协议或文件，及办理其他与本项目相关的一切事宜。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

基于公司的发展战略需要，为把握市场发展机遇，提升公司市场竞争力和综合实力，公司、控股子公司广东芯成汉奇（作为晶圆级先进封测制造项目一期、二期、三期实施主体），拟与东莞松山湖新技术产业开发区管理委员会签订《晶圆级先进封测制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为 45 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中固定资产投资 40 亿元（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等）。

（二）投资标的的信息

1、项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	晶圆级先进封测制造项目三期
项目主要内容	晶圆级先进封测扩产（含设备投资、厂房装修等）
建设地点	东莞市生态园兴业路与东兴西路交汇处东南侧地块
项目总投资金额（万元）	本项目总投资额约为 450,000 万元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中固定资产投资 400,000 万元（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等）
项目建设期	拟于 2029 年 12 月 31 日之前完成本项目固定资产投资额
预计投资收益率	不适用

是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否
------------	--

2、各主要投资方出资情况

本项目资金来源为广东芯成汉奇自有及自筹资金（含第三方对广东芯成汉奇的增资款、银行贷款等），不涉及募集资金。如广东芯成汉奇后续引入新投资者，公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，履行审议程序，并及时进行信息披露。

3、项目目前进展情况

本次投资事项经公司董事会审议通过并经广东芯成汉奇履行相应内部程序后，公司将尽快推进项目合作协议的签署工作，推动项目落地事宜。

4、项目市场定位及可行性分析

随着半导体工艺逼近物理极限，先进封装是“超越摩尔定律”的重要途径。其具有小型化、轻薄化、低功耗与功能集成的优势，可广泛用于智能终端、高性能计算等新兴领域。通过先进封装技术提升芯片性能成为集成电路行业技术发展趋势。广东芯成汉奇依托本项目增强自主创新能力，推动半导体晶圆级先进封测关键技术攻关突破，推动多芯片系统集成封装与存算合封技术产业化及规模量产，促进半导体产业链供应链安全。

（三）出资方式及相关情况

本项目资金来源为广东芯成汉奇自有及自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

（一）签署主体

甲方：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会

乙方：广东芯成汉奇半导体技术有限公司

丙方：深圳佰维存储科技股份有限公司

（二）协议主要内容

1、项目概况

甲方、乙方、丙方于 2023 年 11 月 23 日签订《东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资意向协议》，约定由乙方在松山湖投资建设晶圆级先进封测制造项目（一、二期，下称“原项目”）。为进一步支持乙方扎根东莞发展，继续扩大经

营投资，根据国家和地方有关法律法规，甲乙丙三方本着平等自愿、互利共赢、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方在松山湖增资扩建晶圆级先进封测制造项目三期签订合作协议。

（1）本协议项下的项目是指乙方承诺在松山湖投资建设晶圆级先进封测制造项目三期。

（2）本项目投资额约为肆拾伍亿元人民币（小写¥4,500,000,000 元），其中固定资产投资¥4,000,000,000 元（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等）。

2、项目扶持

自本协议签订之日起五年内，甲方依法依规支持乙方申报研发创新、技术攻关、技术改造、科技成果转化、高质量发展等方面综合性政策奖励。原项目的优惠政策和有关奖励/扶持，按原协议执行，不计入本协议约定的综合性政策支持总金额，亦不与本协议约定的综合性政策支持总金额相互抵扣。

3、项目效益

乙方在产能、固定资产投资额、工业总产值、财政贡献、引进人才数量等方面做出一定的效益承诺。

4、项目用地

本项目不涉及新增用地，增资扩建内容在原项目工业用地（位于东莞市生态园兴业路与东兴西路交汇处东南侧地块）内完成。

5、其他约定

（1）甲方有权指定职能部门对乙方履行本合作协议项下义务进行监督，并就乙方履约不当或相关违约行为适时要求乙方进行整改。

（2）乙方存在约定时间内整体项目产能、固定资产投资额、产值任何一项指标未能达到本合作协议约定的一定标准的，甲方有权停止实施本协议第三条所述优惠政策和奖励。

（3）乙方在考核期结束后整体项目产能、固定资产投资额、产值中任何一项指标未能达到本协议约定的一定标准的，乙方应在本协议第四条约定的对应指标考核期结束后一定期限内，按本协议约定的比例主动向甲方退还已到账的本协议第三条所述的优惠政策支持资金。多项指标未达标的，按本协议约定的比例进

行退还（各指标不重复累计退还）。

（4）甲方有权在本协议约定时间内对乙方整体项目财政贡献逐年进行考核，若乙方在本协议约定时间内财政贡献未能达到本协议约定评价标准的，甲方有权要求乙方支付本协议约定的金额作为违约金。违约金履约路径由甲乙双方友好协商确定。如乙方存在本协议第五条第3款约定的情形，并已按第五条第3款约定的最高比例向甲方退还政策支持资金的，则退还政策支持资金的当年起，财政贡献考核指标按本协议约定的公式同步下调。若乙方财政贡献未达到调整后标准的，甲方有权要求乙方支付本协议约定的金额作为违约金。

（5）在本协议履行期间，如因战争、国家宏观调控、国家或省政府相关法律法规、政策的重大调整等不可抗力因素，导致本协议无法按约定履行，双方互不承担违约责任。

（6）甲方根据乙方项目建设规模及进度，依法合规支持乙方分阶段申报本协议项下第三条所述的优惠政策与奖励。在乙方符合相关政策支持条件的前提下，甲方应在乙方提交完整、合法、有效的申报材料之日起一定期限内完成审核，并自审核通过之日起一定期限内按相关规定向乙方拨付政策资金。如甲方未按本款约定时间及时、足额拨付资金，本协议第四条约定的固定资产投资额、产值、财政贡献及其他指标，按协议约定的规则处理。

6、本协议约定与原协议不一致的，以本协议为准；本协议未涉及的，按原协议执行；原项目的优惠政策和有关奖励/扶持，以及效益约定评价标准，按原协议执行。

7、本协议在广东省东莞松山湖高新技术产业开发区签订，本合作协议自“《东莞松山湖高新区关于助推产业高质量发展的若干措施（试行）》”政策发布之日起生效。

四、对外投资对上市公司的影响

公司晶圆级先进封测项目投产后，将有力强化大湾区在全球半导体产业格局中的竞争优势，为我国集成电路产业高质量发展注入新动能。广东芯成汉奇依托本项目增强自主创新能力，推动半导体晶圆级先进封测关键技术攻关突破，推动多芯片系统集成封装与存算合封技术产业化及规模量产，促进半导体产业链供应链安全。

五、对外投资的风险提示

1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性；项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险；

2、广东芯成汉奇作为本项目经营实体，承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯成汉奇无法履约时，公司须对广东芯成汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任，补充责任以公司对广东芯成汉奇的持股比例为限。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日